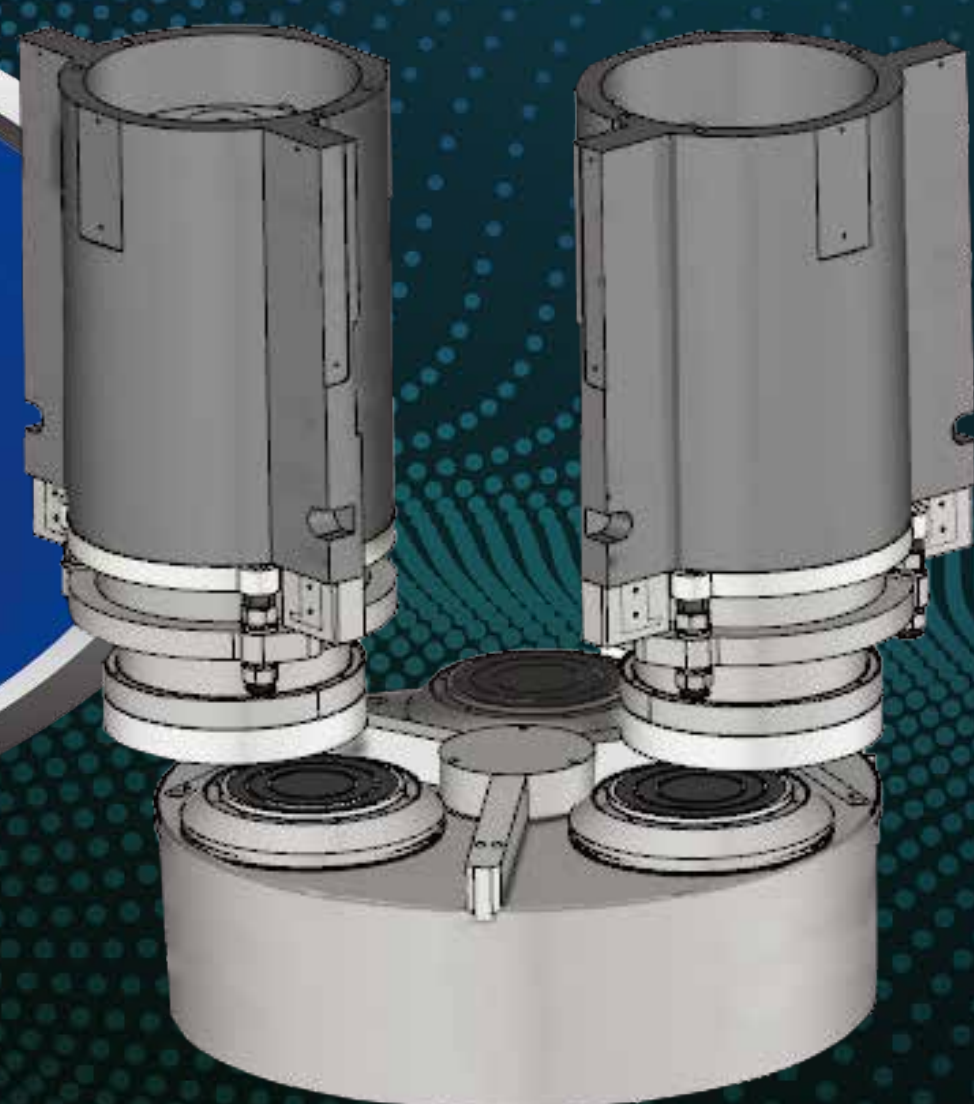


# ウェーハの高効率検索加工機を提案します

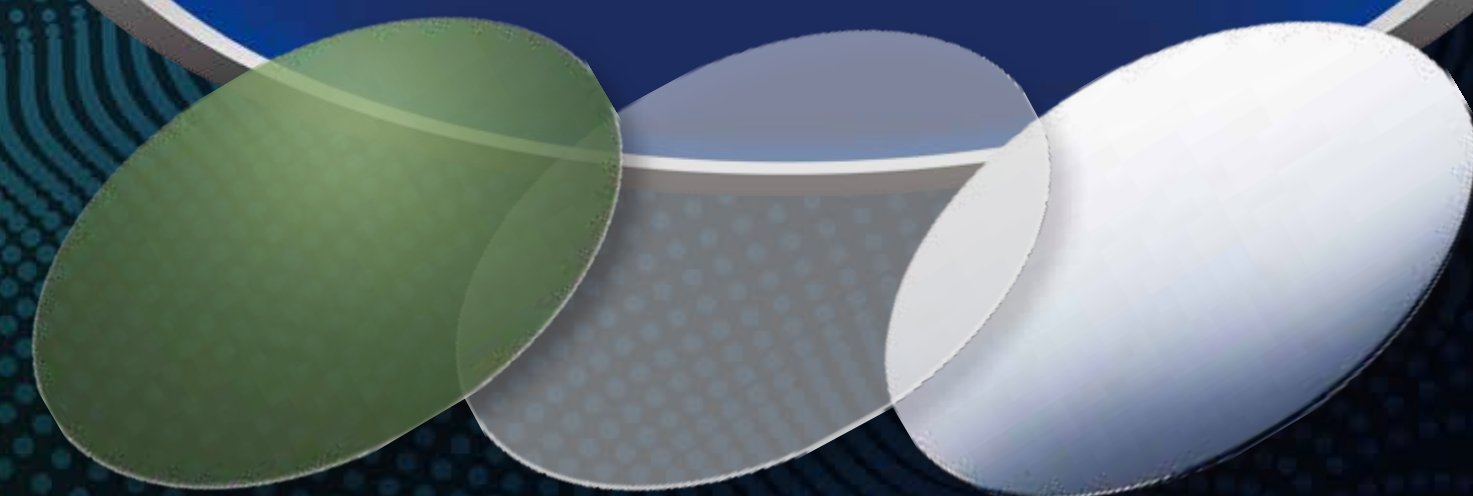
Xxx

# JTEKT

2スピンドル・3チャック  
テーブル  
2 Spindle & 3 Chuck  
table



硬脆材料ウェーハ  
Hard Brittle Wafers



SiC Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> GaN etc

## 硬脆材料ウェーハ研削盤 DDT832

Hard and Brittle Wafers Grinder

new  
新機種

## POWERFUL & COMPACT



特許  
取得済  
PATENTED

〔新型：V字配置〕  
[DDT832V-shape layout]



機械特長  
Features

- **ハイパワースピンドル  
(7.5kW / 11kW切替式) を搭載し  
高トルク性能を維持**  
High power spindle (Built-in 7.5kW/11kW switchable)  
maintains high torque performance.
- **新コラム構造による  
新たなスピンドル配置で  
機械本体をスリム化**  
New spindle arrangement with a new column structure  
realizes machine body slimmer.
- **硬質・難削材料ウェーハの  
高効率加工**  
High efficient grinding of hard and difficult-to-machine  
material wafers.
- **高速搬送による高スループット**  
High throughput due to high-speed transport.
- **画像処理による  
トレーサビリティの強化**  
Enhanced traceability through image processing.

JTEKT MACHINE SYSTEMS CORPORATION